

あらゆる業界に貢献するアルバック機工

小型マグネトロンスパッタリング装置

SCOTT - C1



概要・特長

平行平板型RFマグネトロン放電方式で
絶縁物はもとより、半導体や金属の
スパッタリングが可能。

一元4インチのカソードなので広範囲の
成膜が可能。

豊富なオプションで、目的、用途に応じ
て種々のカスタマイズ。

エッチング機構を標準搭載。

仕様

基板サイズ・数量	4インチ×1mm 1ヶ	基板加熱温度	Max 350
有効成膜範囲	50mm	基板・電極間距離	60mm
RF電源	Max 300W(40~300可変)	外觀寸法	1102(W)×704(L)×1262(H)
成膜速度	30nm/min以上(SiO ₄)	装置質量	約500kg
成膜分布	50mm領域±10%以内(SiO ₄)	所要電気量	単相100V(50/60Hz) 3.0kVA
真空槽到達圧力	6.6×10 ⁻³ Pa(無負荷清浄時)	所要水量	約16L/min (200kPa)
排気時間	大気圧から6.6×10 ⁻⁴ Pa迄5分以内		

Creating Small Vacuum Pumps

ULVAC

アルバック機工株式会社

www.ulvac-kiko.com



本社・営業部 〒222-8522 横浜市港北区新横浜2-7-19(天幸ビル50) TEL 045-474-2011 FAX 045-474-2010

大阪支店 TEL 06-6453-2621

西東京支店 TEL 042-549-7651

東京事務所 TEL 03-3517-6834

京都支店 TEL 075-257-4751

仙台支店 TEL 022-358-7522

C Sセンター TEL 045-474-3063

名古屋支店 TEL 0586-73-6991

福岡支店 TEL 092-473-9541

鹿児島工場 TEL 0995-72-1122

埼玉支店 TEL 048-467-9971

技術開発センター TEL 045-474-2125

宮崎工場 TEL 0983-42-1411